



Polo scientifico tecnologico

Via Bovio 6 – 28100 Novara - NO - Italy

Tel +39 0321697200 - Fax +39 0321 688515 - Email: info@etneo.com

www.etneo.com

STAZIONE DI REWORK BGA/SMD INFRAROSSO MODELLO E7610



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

1. Non utilizza ugelli, non ci sono flussi d'aria durante i processi di re work.
2. Resistenza superiore con tecnologia dark-infrared ad apertura regolabile per il riscaldamento, grande area inferiore di pre-riscaldamento a infrarosso, verticale diminuzione della differenza di temperatura tra la superficie del BGA e i giunti di saldatura, processo di re work molto breve in termine di tempi.
3. Utilizza un sensore di temperatura infrarosso non a contatto, controllo della temperatura a circuito chiuso sulla superficie del BGA, assicura un preciso processo di temperatura e anche di distribuzione del calore.
4. La struttura di fissaggio dei PCB può essere spostata in 4 direzioni, di facile installazione.
5. Gestione di inserimento dei profili e dei parametri tramite software IRSOFT con un'interfaccia molto intuitiva.
6. Ventola laterale per la fase di raffreddamento.
7. RPC camera per visualizzazione dei processi in tempo reale **opzionale**.

SPECIFICHE TECNICHE:

Potenza generale	2400W (Max)
Potenza preriscaldamento inferiore	1600W (Infrared ceramic heating plate)
Potenza resistenza superiore	720W (Infrared heating tube, 2-8µm wave length, size: 60*60mm)
Area preriscaldamento inferiore	260*260mm
Max dimensione PCB	420*500mm
Max/Min dimensione BGA	60*60mm - 2*2mm
Comunicazione esterna	Standard RS-232C (Collegamento a PC)
Sensore temperatura infrared	0-300°C (Temperature range)
Dimensioni	80*58*52 (cm)
Peso	36,0 Kg

TELECAMERA LATERALE RPC:

Modello: E RPC2005

Potenza: 15 Watt

Sistema di visione: 22*10 times magnifying - 12V - 300ma

Risoluzione: 480 linee

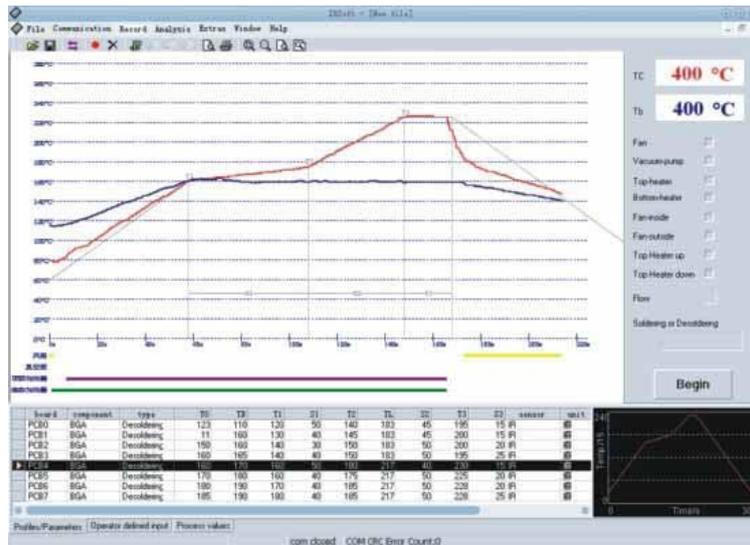
Illuminazione: a LED

La camera ad alta definizione laterale dotata di illuminazione a led consente di ispezionare il processo di rework e quindi la perfetta rifusione delle sfere del BGA.



Software IR:

Il software in dotazione può essere utilizzato per vedere, memorizzare, settare ed analizzare le curve di temperatura di ogni singolo profilo di rework.



Il processo di reflow del BGA include 5 fasi: 1 PRERISCALDO – 2 MANTENIMENTO TEMPERATURA – 3 ATTIVAZIONE FLUSSANTE – 4 SALDATURA – 5 RAFFREDDAMENTO. La fase 1 PRERISCALDO prepara la scheda al re work.

La fase 2 MANTENIMENTO T elimina le differenze di temperatura tra i componenti o tra scheda e componenti per evitare deformazioni della scheda stessa.

La fase 3 attiva chimicamente il fluxante.

Durante la fase 4 il riscaldamento raggiunge la massima temperatura per favorire la saldatura del BGA:

TL: punto di fusione delle sfere (solitamente lead free con punto di fusione intorno ai 217°C, oppure con piombo 183°C);

T1: temperatura iniziale della fase 2;

T2: temperatura finale della fase 2 (questi due valori vengono selezionati in relazione alle dimensioni del BGA e della scheda, ed alla q.tà di componenti sulla scheda);

T3: il picco di temperatura durante la fase 4 (solitamente per lead free è intorno ai 235°C e piombo 203°C);

T0: valore di temperatura del preriscaldamento inferiore raggiunto il quale si attiva il riscaldamento superiore;

TB: la T° settata per il BOTTOM;

Tb: la T° in tempo reale per il BOTTOM;

Tc: la T° in tempo reale sul BGA;

S1: tempo rampa di temperatura tra T1 e T2;

S2: tempo rampa di temperatura tra T2 e T3;

S3: tempo di prolungamento del riscaldamento una volta raggiunto il picco T3.

KIT MANUTENZIONE:

